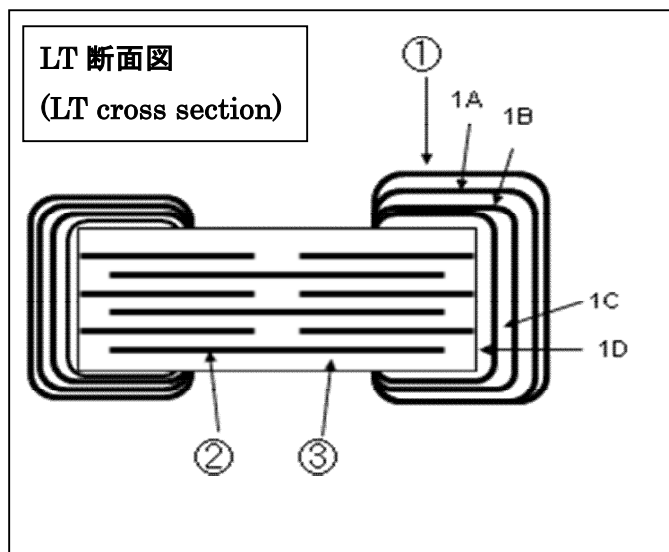
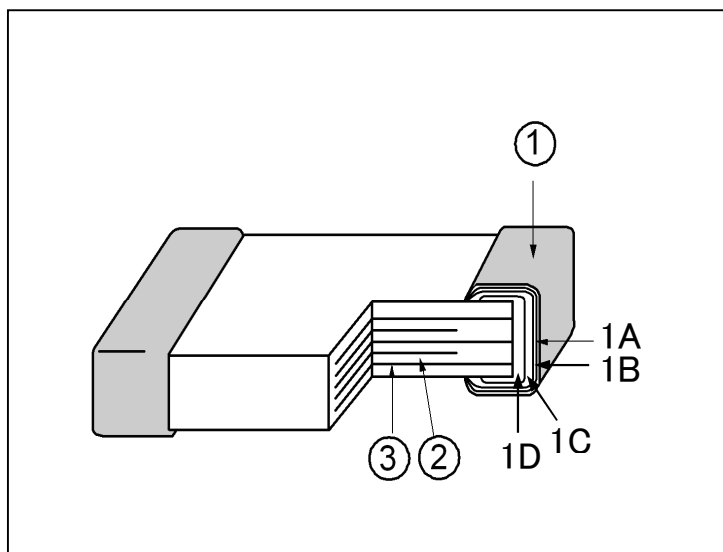


チップ積層セラミックコンデンサ 構造図および材料表
 Structure and Material of Chip Multilayer Ceramic Capacitor

<MLSC+樹脂電極GCEシリーズ>
 <Soft termination MLSC Serial GCE Series>

1. 内部構造/Example of Structure



2. 名称と材料名/Name and Material

No.	名称/Name	主原料/Material
①	外部電極 Termination	
1A	めっき層 Plated layer	すず Tin
1B	めっき層 Plated layer	ニッケル Nickel
1C	下地電極 Electrode	導電性樹脂 Conductive Resin
1D	下地電極 Electrode	銅 Copper
②	誘電体素子 Dielectric layer	チタン酸バリウム系 Ceramic
③	内部電極 Inner electrode	ニッケル Nickel